三次元デジタイザによる寸法測定条件の最適化(第2報)

Optimization of dimensional measurement condition by 3D digitizer (2nd report)

技術開発部 生産・加工科 清野若菜 近野裕太 技術開発部 工業材料科 矢内誠人 南相馬技術支援センター 機械加工ロボット科 夏井憲司 いわき技術支援センター 機械・材料科 緑川祐二

三次元デジタイザによる形状測定から得られる寸法値の精度を明確化し、向上させるこ とを目的として、品質工学的手法により測定精度に影響を与える条件の最適化を行った。測 定物表面の塗布物を酸化チタン粉末に変更してL18直交表による実験を行った結果、カ メラ角度及び参照点の有無が測定精度に大きく影響することが分かった。設定した最適条 件を用いた金属製凸型ブロックの測定では、従来の条件に比べて寸法測定誤差を大幅に改 善することができた。

Key words: 三次元デジタイザ、品質工学

1. 緒言

図面のない金型等の現物からCADデータを作成す るリバースエンジニアリングの用途として、非接触三 次元デジタイザによる形状測定が行われている。三次 元デジタイザは、複雑な形状を短時間で三次元的に測 定できるメリットがある一方、カメラの撮影画像から 3Dデータを作成するため、寸法の測定精度は高くな い。三次元デジタイザを用いて、精度よく寸法を測定 したいという産業界のニーズはあるものの、測定値に 影響する要素が多数あるため、精密な寸法測定の用途 には利用されていない。

三次元デジタイザによる形状測定から得られる寸法 値の精度を明確化し、向上させることを目的として本 研究を実施した。

今年度は、測定物表面への塗布物を従来の浸透探傷 用現像液から、より粒径の小さい酸化チタン粉末に変 更し、品質工学的手法を用いた実験により、測定精度 に影響を与える条件の最適化を行った。

2. 実験と考察

2. 1. 測定原理

測定機は非接触三次元デジタイザ(ATOS Compact Scan 5M: GOM 製)を使用した。測定原理は、パターン 投影方式とステレオ方式を組み合わせたエリア計測方 式である¹⁾。本測定機には、中央にプロジェクタレン ズとその左右にカメラレンズが設置されており、プロ ジェクタから青色光による格子パターンを投影し、測 定物の表面形状によって変形した状態を左右のカメラ で撮影する。1回の撮影で取得できる座標点数は約 500万点であり、左右の画像の視差から三角測量によ り奥行方向の距離を測定し、測定物表面の点群データ を取得する。ターンテーブルを回転させて複数の角度

表1 センサ設定

カメラ間距離	[mm]]	300		
レンズ名称			MV300		
測定範囲 (横幅×縦幅×奥行)	[mm]]	$300 \times 230 \times 230$		
点間ピッチ	[mm]		0.124		
参照点の径	$[\operatorname{mm} \phi]$		1.5		
測定距離	[mm]		590		
カメラ間角度	[°]]	25		
ハードウェア上の操作	乍		ソフトウェア上の操作		
① 起動		不要な部分を削除			
¥			\checkmark		
② 暖機(30分間) ⑦		ポリゴン化して更新			
↓			\checkmark		
③ キャリブレーション (校正有の場合)	/	8) フィッティング平面 の作成		
<u>↓</u>			¥		
④ 測定物設置 ④		9)基点ポイントの描画		

図1 寸法測定の流れ

10 投影距離の測定

⑤ 回転テーブルで測定

から撮影し、参照点の座標値又は特徴形状を基準とし たベストフィットにより合成することで、測定物全体 の3Dデータを作成している。

表1にセンサの設定を示す。測定に用いるレンズは、 測定範囲の異なる大中小の3種類が存在するが、本研 究では最も使用頻度の高いMV300(中)を使用した。

図1に本研究での形状及び寸法測定の流れを示す。 測定した点群データはソフトウェア上でポリゴン化し、 測定面に沿ったフィッティング平面の作成と基点ポイ ントの描画を行った後、基点から平面までの投影距離 を測定した。

2. 2. 酸化チタン粉末を用いた際の最適条件の導出 2. 2. 1. 実験に使用した測定物

セラミック 45[mm] ブロックゲージ((株) ミツトヨ製) を使用し、測定面は精度保証された両端面とした。測 定時は、無水エタノール中に分散させた酸化チタン粉 末を、エアブラシを用いて測定物表面に塗布した。

2. 2. 2. L18直交表の作成

測定精度に影響を与えるパラメータを明らかにする ため、品質工学のL18直交表を作成し、実験を行っ た。直交表に割り付けるパラメータ及び水準を表2に、 パラメータの概念図を図2に示す。これらは昨年度の 設定項目と同じにした。ショット数はターンテーブル 1回転当たりの撮影数、測定物位置はターンテーブル 回転中心からの距離を示す。カメラ角度及び露光量は、 測定物がターンテーブル中心に設置され、かつ測定面 中央に焦点が合った状態で設定した。なお露光量は、 ソフトウェア上で自動調整される値を通常とし、露光 過多・過少になる限界点をそれぞれ多・少とした。寸 法測定箇所は、測定物平面上で投影距離を測定する位 置を示す。参照点の有無は、測定物の土台及び左右腕 部に参照点を貼付した場合を有、貼付しない場合を無 とした。特徴形状は、測定物左右に非対称形状のパー ツを取り付けた。

パラメータ 水準2 水準3 水準1 無 校正有無 有 _ ショット数 8 12 24 中心から 中心から 中心 測定物位置 5[cm] 10[cm] カメラ角度「゜] 55 35 45 露光量 诵常 小 多 中央 上側 寸法測定箇所 下側 参照点有無 有 錘 無(特徴形状)

表2 パラメータ条件の割振り



図2 パラメータ概念図

	パラメータ(制御因子)							
試験 No.	校正	ショット数	測定物位置	カメラ角度[゜]	露光量	寸法測定位置	参照点	誤差
1	有	12	中心	45	通常	上側	無	e1
2	有	12	中心から 5[cm]	55	少	下側	無(特徴形状)	e2
3	有	12	中心から 10[cm]	35	多	中央	有	e3
4	有	8	中心	45	少	下側	有	e3
5	有	8	中心から[5cm]	55	多	中央	無	e1
6	有	8	中心から 10[cm]	35	通常	上側	無(特徵形状)	e2
7	有	24	中心	55	通常	中央	無(特徵形状)	e3
8	有	24	中心から 5[cm]	35	少	上側	有	e1
9	有	24	中心から 10[cm]	45	多	下側	無	e2
10	無	12	中心	35	多	下側	無(特徴形状)	e1
11	無	12	中心から 5[cm]	45	通常	中央	有	e2
12	無	12	中心から 10[cm]	55	少	上側	無	e3
13	無	8	中心	55	多	上側	有	e2
14	無	8	中心から 5[cm]	35	通常	下側	無	e3
15	無	8	中心から 10[cm]	45	少	中央	無(特徵形状)	e1
16	無	24	中心	35	少	中央	無	e2
17	無	24	中心から 5[cm]	45	多	上側	無(特徴形状)	e3
18	無	24	中心から 10[cm]	55	通常	下側	有	e1

表3 L18直交表への割付け

作成したL18直交表を表3に示す。実験は、各試 験 No.当たり3回ずつ測定した。直交表第8列の誤差 は、各試験 No.間の繰り返し測定誤差を示す。

2. 2. 3. SN比の算出及び結果

SN比の要因効果図を図3に示す。各パラメータの 水準別SN比は、関係する試験 No.のSN比を平均し た値である。誤差のSN比の上下幅とほぼ同一のパラ メータは、測定精度への影響が小さい。このことから、 測定精度に影響を与えるパラメータは、カメラ角度及 び参照点有無であることが分かった。なおこのSN比 は、信号量Sと誤差Nの比であり、SN比が大きいほ どばらつきが少なく、寸法値に対する誤差が小さいこ とを表している。SN比の算出式を以下に示す^{2),3)}。

$$\eta = 10 \log \left(\frac{1}{n} \cdot \frac{S_m - V_e}{V_e} \right) \tag{1}$$

$$S_m = \frac{(\sum y)^2}{n} \tag{2}$$

$$V_e = \frac{(\sum y - \bar{y})^2}{r} \tag{3}$$

	-	• =			
у	:	出力(測定値)	п	:	データ数
S_m	:	一般平均	V_e	:	誤差分散
η	:	SN比 [dB]			

2.3.実験の妥当性の確認

導出したSN比の妥当性を確認するため、各パラメ ータのSN比が高い水準の組み合わせを最適条件、低 い水準の組み合わせを最悪条件とし、セラミック製 45[mm]ブロックゲージの測定実験を行った。

実験結果から導出したSN比を表4に示す。計算値 のSN比は、L18直交表による実験結果から導出し たSN比の全平均と各水準のSN比の差分を求め、そ れらの差分の合計に全平均を加えたものである。最適 条件及び最悪条件ともに、計算値と実験値の差が± 30[%]以内であったため、導出した最適条件は妥当であ るといえる。

2. 4. 最適条件を用いた測定実験

2. 4. 1. 実験に使用した測定物

測定物は金属製凸型ブロックを使用した。寸法測定 箇所を図4に示す。測定物の寸法の真値は、CNC三 次元座標測定機(UPMC550CARAT:カールツァイス製) で測定した値を用いた。

測定物表面には、低圧スプレーガンを用いて酸化チ タン粉末を一様に塗布した。塗布液は、酸化チタン粉 末 1[g]及び無水エタノール 50[mL]をプラスチック製 のボトルに入れ、超音波洗浄装置にて5分間攪拌した ものを使用した。



図3 SN比の要因効果図

表4 SN比検証結果

	最適条件	最悪条件
計算值SN比[dB]	103.92	51.23
実験値SN比[dB]	80.48	67.71
誤差[%]	-29	+24





図4 左 金属製凸型ブロック 右 寸法測定箇所

表5 最適条件のパラメータ設定

パラメータ	最適条件		
校正有無	有		
ショット数	12		
測定物位置	中心		
カメラ角度 [゜]	45		
露光量	多 (9.50[ms])		
寸法測定箇所	中央		
参照点有無	有		

2. 4. 2. 最適条件のパラメータ設定

最適条件として設定したパラメータを表5に示す。 露光量は、ソフトウェア上で露出過多とならない最大 値として、9.50[ms]に設定した。参照点は、ターンテ ーブル及び測定物下部に取り付けたパーツに貼付した。 測定物位置は、繰り返し誤差と比較してSN比が小さ く測定精度への影響が少ないことから、配置が容易な 中心とした。

2. 4. 3. 測定結果

最適条件を用いた測定実験の結果を表6に示す。通 常使用している浸透探傷用現像液を塗布した状態での 最適条件及び通常条件の結果は、昨年度の値である。 酸化チタン粉末を塗布した状態での最適条件の誤差は、 A部で 0.010[mm]、B部で 0.012[mm]となった。通常条 件での誤差との比は、当初の目標である 3 分の 1 を下 回った。

2.5.塗布物の観察

浸透探傷用現像液を塗布した状態よりも、酸化チタ ンを塗布した状態での測定誤差が小さくなった理由を 調べるため、走査型電子顕微鏡 (S-3700N: (株)日立ハ イテク製)を用いて塗布物の表面観察を行った。サン プルは、浸透探傷用現像液及び酸化チタン粉末をそれ ぞれブロックゲージの表面に塗布し、電子顕微鏡用カ ーボンテープに転写させた後、スパッタリング装置 (JUC5000:日本電子(株)製)を用いて白金をコーティ ングした。電子顕微鏡での観察条件は、焦点距離6[mm]、 加速電圧 10[kV]とした。観察結果を図5、図6に示す。 図5は倍率2000倍、図6は7000倍で撮影した画像で あり、1目盛の値は前者が2.0「μm]、後者が0.5「μm] である。図5から、浸透探傷用現像液は粒の大きなも のと小さなものが混在していることが分かる。粒子の 大きさは最大で約 10~20 [µm] であることが確認され た。一方、図6から酸化チタン粉末の粒子の大きさは ほぼ一様で、0.5[μm]以下であることが分かった。

測定物表面に塗布物を塗布した場合、測定物自体の 寸法は真値よりも膜厚の分大きくなる。そのため、浸 透探傷用現像液を塗布した状態での最適条件の結果に は、粉末の粒径以上の誤差が含まれていたと考えられ る。一方、今年度使用した酸化チタン粉末の粒径は、 浸透探傷用現像液よりも十分に小さいことから、測定 物寸法の真値からのずれが最小限に抑えられ、測定誤 差が小さくなったと考えられる。

3. 結言

品質工学的手法を用いて、三次元デジタイザの測定 精度に影響を与える測定条件の最適化を行った。測定 物表面への塗布物を従来の浸透探傷用現像液から酸化 チタン粉末に変更し、L18直交表による実験から導 出した最適条件を用いて金属製凸型ブロックを測定し た結果、従来の条件と比較して寸法測定誤差を大幅に 改善することができた。

参考文献

- 吉澤徹. "エリア計測方式による三次元計測".最 新光三次元計測.朝倉書店,2006, p.31-58
- 広瀬健一,上田太一郎.Excel でできるタグチメソ ッド解析法入門.同友館. 2003, 246p.
- 3) 田口玄一, 横山巽子. ベーシック品質工学へのと びら. 日本規格協会. 2007, 195p.

表6 測定結果

		A [mm]	B [mm]	
三次元測定機(真値)		50.011	25.020	
最適条件 (酸化チタン)	1	50.023	25.034	
	2	50.020	25.033	
	3	50.013	25.024	
	4	50.015	25.026	
	5	50.032	25.044	
	平均	50.020	25.032	
	誤差	+0.010	+0.012	
最適条件		+0 026	+0 027	
(浸透探傷用現像液)	映左	+0.030	+0.037	
通常条件	調美	+0 093	+0.094	
(浸透探傷用現像液)	际上	10.095	0.054	



図5 浸透探傷用現像液の観察結果



図6 酸化チタン粉末の観察結果